

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 关于为相关银行授信额度提供资产补充抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、补充抵押担保情况概述

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币12,000万元的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“建设银行深圳分行”）申请流动资金贷款人民币12,000万元。（内容详见公司于2020年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-054））。

根据建设银行深圳分行的要求，公司拟以位于深圳市南山区松坪山高新住宅部分自有房产为公司向建设银行深圳分行此次授信额度提供补充抵押担保，担保额度1亿元，担保期限不超过1年，本次公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度补充抵押担保事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本次补充抵押担保在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：深圳丹邦科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300732076027R
- 3、住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
- 4、法定代表人：刘萍
- 5、注册资本：54,792万元

6、成立日期：2001年11月20日

7、经营范围：开发柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	241,740,185.86	347,148,108.89
利润总额	-4,717,286.21	16,118,034.51
净利润	-5,113,464.26	17,335,035.40
项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	2,539,902,850.80	2,492,634,263.05
负债总额	811,698,231.55	757,273,990.73
所有者权益	1,728,204,619.25	1,735,360,272.32
资产负债率	31.96%	30.38%

### 三、补充抵押担保合同的主要内容

公司拟与建设银行签订补充抵押担保合同，抵押资产详情如下：

担保物：深圳市南山区松坪山高新住宅部分自有住宅所有权

担保方式：抵押担保

担保金额：1亿元

抵押担保期限：不超过1年

授权公司法定代表人刘萍先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述担

保额度内的一切与担保（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### **四、董事会意见**

本次公司以自有房产为公司向建设银行深圳分行申请的综合授信额度提供补充抵押担保事项系满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。此次抵押的自有房产为公司 100%持有，财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

#### **五、公司累计对外担保情况**

截至目前，公司及全资子公司累计对外担保总额为 73,000 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 42.07%，占公司 2019 年经审计总资产的 29.29%。公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **六、独立董事意见**

关于公司以自有房产为公司向建设银行深圳分行相关综合授信额度提供补充抵押担保，系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

基于以上判断，我们同意公司以其自有房产为公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度提供补充抵押担保。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020年11月30日